

Sn100Ni+®

Sn99Ag+® • Sn98Ag+® • Sn96Ag+® • Sn95Ag+®



Elektroniklote

ISO-Tin® NiGe-Elektroniklote

aus Reinetallen erster Schmelze

für den Einsatz in Wellen-, Selektiv- und Tauchlötbadern

Format	Abmessung
ca. 0,400 kg Stangen	330 x 20 x 10 mm
ca. 1,000 kg Stangen	330 x 20 x 20 mm
ca. 3,500 kg Blöcke mit Aufhängeöse	545 x 47 x 20 mm

Auch als Massivdraht auf Spulen zur automatischen Zuführung und als Kegel / Pellets zur Erstbefüllung lieferbar.

HAL-Lote

ISO-Tin® NiGe-HAL-Lote

aus Reinetallen erster Schmelze

für die Heißluftverzinng in der Leiterplattenfertigung

Format	Abmessung
ca. 0,400 kg Stangen	330 x 20 x 10 mm
ca. 1,000 kg Stangen	330 x 20 x 20 mm
ca. 3,500 kg Blöcke mit Aufhängeöse	545 x 47 x 20 mm

Auch als Massivdraht auf Spulen zur automatischen Zuführung und als Kegel / Pellets zur Erstbefüllung lieferbar.

Die Legierungen aus der Sn100Ni+Familie sind bekannt für Ihre guten Löteigenschaften, die glänzenden Lötstellen und die Verringerung der Kupferablagierung. In vielen Tests haben die NiGe-Lotlegierungen ihre Zuverlässigkeit unter Beweis gestellt.

	Produkt	Legierung	EN ISO 9453	Schmelzbereich	empf. Lötwell- lentemperatur	Anwendung
Wellenlöten	Sn100Ni+®**	Sn99,3Cu0,7AgNiGe	Sn99,25Cu0,7Ni0,05	227 °C eutektisch	≥ 265 °C	Wellenlöten Selektivlöten Tauchbadlöten
	Sn100Ni+®-Refill**	Sn99,9NiGe	-	Refill für Sn100Ni+®		
	Sn99Ag+®**	Sn99Ag0,3Cu0,7NiGe	-	217 - 227 °C	≥ 260 °C	
	Sn98Ag+®**	Sn98Ag1,2Cu0,7NiGe	-	217 - 222 °C	≥ 255 °C	
	Sn96Ag+®**	Sn96,5Ag3,0Cu0,5NiGe	-	217 - 219 °C	≥ 255 °C	
	Sn95Ag+®**	Sn95,5Ag3,8Cu0,7NiGe	-	217 °C eutektisch	≥ 255 °C	
HAL- Verzinnung	HAL-Sn100Ni+®**	Sn99,3Cu0,7AgNiGe	Sn99,25Cu0,7Ni0,05	227 °C eutektisch	≥ 277 °C	Heißluftverzinng
	HAL-Sn100Ni+®-Refill	Sn99,9NiGe	-	Refill für HAL-Sn100Ni+® (gem. Cu-Gehalt)		
	HAL-Sn99Ag+®**	Sn99Ag0,3Cu0,7NiGe	Sn99Cu0,7Ag0,3(NiGe)	227 °C eutektisch	258 - 268 °C	
	HAL-Sn99Ag+®-Refill	Sn99,7Ag0,3NiGe	-	Refill für HAL-Sn99Ag+® (gem. Cu-Gehalt)		

** Fuji-Patent: DE-Patent-Nr. 19816671C2; US-Patent-Nr. 6.179.935B1; Japan-Patent-Nr. 3296289

Alle Elektroniklote sind selbstverständlich auch kupferfrei als REFILL-Lot erhältlich. Unsere bleifreien Lote entsprechen der Richtlinie RoHS und somit auch dem ElektroG. Eine entsprechende Konformitätserklärung stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung. **Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Vorteile unserer NiGe-dotierten Elektroniklote. Fordern Sie unsere detaillierten Produktinformationen an.**

SN100-403C



Elektroniklote

ISO-Tin® SN100-403C

aus Reinmetallen erster Schmelze

für den Einsatz in Wellen-, Selektiv- und Tauchlötbadern

Format	Abmessung
ca. 0,250 kg Dreikantstangen	10 x 10 x 10 x 400 mm
ca. 1,000 kg Stangen	330 x 20 x 20 mm
ca. 3,500 kg Blöcke mit Aufhängeöse	545 x 47 x 20 mm

Auch als Massivdraht auf Spulen zur automatischen Zuführung und als Kegel / Pellets zur Erstbefüllung lieferbar.

Die Legierungen aus der SN100-403C-Familie sind bekannt für Ihre guten Löteigenschaften, die glänzenden Lötstellen und die Verringerung der Kupferablagierung. In vielen Tests hat das Lot SN100-403C seine Zuverlässigkeit unter Beweis gestellt.

HAL-Lote

ISO-Tin® SN100-403CL

aus Reinmetallen erster Schmelze

für die Heißluftverzinngung in der Leiterplattenfertigung

Format	Abmessung
ca. 0,250 kg Dreikantstangen	10 x 10 x 10 x 400 mm
ca. 1,000 kg Stangen	330 x 20 x 20 mm
ca. 3,500 kg Blöcke mit Aufhängeöse	545 x 47 x 20 mm

Auch als Massivdraht auf Spulen zur automatischen Zuführung und als Kegel / Pellets zur Erstbefüllung lieferbar.

	Produkt	Legierung	EN ISO 9453	Legierung Nr.	Schmelzbereich	empf. Lötwell- lontemperatur	Anwendung
Wellenlöten	SN100-403C *	SnCu07NiGe0,0055	Sn99,25Cu0,7Ni0,05	403	227 °C eutektisch	≥ 265 °C	Wellenlöten Selektivlöten Tauchbadlöten
	SN100-403Ce *	SnNiGe0,0055	-		Refill für SN100-403C	≥ 265 °C	
	SN100-403CS *	SnCu07NiGe0,01	Sn99,25Cu0,7Ni0,05	403	227 °C eutektisch	≥ 265 °C	
	SN100-403CeS *	SnNiGe0,01	-		Refill für SN100-403CS	≥ 265 °C	
	SN100-403CS+ *	SnCu07NiGe0,025	Sn99,25Cu0,7Ni0,05	403	227 °C eutektisch	≥ 265 °C	
	SN100-403CeS+ *	SnNiGe0,025	-		Refill für SN100-403CS+	≥ 265 °C	
	SN100-403C3 *	SnCu3NiGe0,0055	-		227 - 310 °C	340 - 420 °C	Tauchbadlöten
	SN100-403C4 *	SnCu4NiGe0,0055	-		227 - 340 °C	380 - 540 °C	
HAL-Verzinnung	SN100-403CL *	SnCu07NiGe0,0055	Sn99,25Cu0,7Ni0,05	403	227 °C eutektisch	≥ 277 °C	Heißluft- verzinnung
	SN100-403CLe *	SnNiGe0,0055	-		Refill für SN100-403CL	≥ 277 °C	
	SN100-403CLe(+) *	SnNi0,15Ge0,0055	-		Refill für SN100-403CL	≥ 277 °C	
	SN100-403CLS *	SnCu07NiGe0,01	Sn99,25Cu0,7Ni0,05	403	227 °C eutektisch	≥ 277 °C	
	SN100-403CLeS *	SnNiGe0,01	-		Refill für SN100-403CLS	≥ 277 °C	
	SN100-403CLeS(+) *	SnNi0,15Ge0,01	-		Refill für SN100-403CLS	≥ 277 °C	

* gefertigt nach NIHON SUPERIOR-Patent: DE-Patent-Nr. 69918758; Europa-Patent-Nr. 0985486

Unsere bleifreien Lote entsprechen der Richtlinie RoHS und somit auch dem ElektroG. Eine entsprechende Konformitätserklärung stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung. **Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Vorteile unserer NiGe-dotierten Elektroniklote. Fordern Sie unsere detaillierten Produktinformationen an.**

 **Made in Germany**